

# LCP 日本住友化学 E6808LHF-BZ-Z连接器专用LCP塑胶原料诚信服务

产品名称	LCP 日本住友化学 E6808LHF-BZ-Z连接器专用LCP塑胶原料诚信服务
公司名称	浩正新材料科技（东莞）有限公司
价格	.00/个
规格参数	赛钢POM:连接器专用LCP塑胶 PFA铁氟龙:光学镜头COC材料 COC材料:PFA铁氟龙粒子粉末
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶路1号55号楼106室
联系电话	18825708836 13794983753

## 产品详情

塑胶原料的主要成份是被称为树脂的高分子化合物基体。

PBT塑胶材料常被用于生产2.54间距180度/90度的排母连接器产品之上，塑料端子壳的耐焊接温度只有200度左右，由于成本相对其它材料低、强度高、耐摩擦等特性，现在这种材料还是有很多客户选择。但是使用这种材料的成型性较差、缩水严重、由于熔化温度较低、过波峰焊时会产生塑料熔化现象。

绝缘材料：PEEK因具有优良的电气性能，在高温、高湿等恶劣条件下，聚醚醚酮的绝缘性能仍能保持，是理想的电绝缘材料，特别是在半导体工业中得到广泛应用。

POM塑胶原料系列可注塑成型，挤出成型，压缩成型，滚塑成型，吹塑成型。应用于齿轮，链轮，滑轮，滑轨，弹簧，支架，卫浴，阀门，导轨，剃须刀，水，夹子，电动牙刷，插座，开关零件，燃油系统部件，玩具，洗衣机，轴承，工具把手，密封垫，淋浴喷头，外壳，座椅安全带扣，拉链，卡扣，纽扣，板材，杆，板料，结构部件和机加工。

由于拥有的粘合持久性和食品卫生性，在食品包装领域赢得了广大客户的信赖。由于引入的官能团的作用，针对聚烯烃的颜料、木粉等多种填料，Admer也可以起到偶联剂的效果，增加这些填料与聚烯烃的相容性。

原料其具有高强度、高刚性、耐高温、电绝缘性等十分优良，被用于电子、电气、光导纤维、汽车及宇航等领域。

塑胶原料的力学性能通常比金属低的多,但有的复合材料的比强度和比模量高于金属,如果制品设计合理,会更能发挥起优越性;

POM-H（聚甲醛均聚物），POM-C（聚甲醛共聚物）是高密度、高结晶度的热塑性工程塑料。

聚甲醛是一种无侧链高密度结晶性聚合物，具有优异的综合性能。

用液晶作成的纤维可以做鱼网、防弹服、体育用品、刹车片、光导纤维及显示材料等，还可制成薄膜，用于软质印刷线路、食品包装等。

塑胶原料按照合成树脂的分子结构分主要有热塑性及热固性塑胶之分：对于热塑性塑胶指反复加热仍有可塑性的塑胶：主要有PE/PP/PVC/PS/ABS/PMMA/POM/PC/PA等常用原料。热固性塑胶主要指加热硬化的合成树脂制得的得塑胶，像一些酚醛塑胶及氨基塑胶。

9T塑胶材料会使用这类材料的连接器产品多为2.54间距贴片排母，和1.27间距/2.0间距系列排母。耐焊接温度在260度-300度左右，由于使用这种材料价格昂贵，一般是客户有特殊需求才会使用9T塑胶材料来生产连接器产品。

通用塑料这类塑料时一类用途十分广泛的塑料，它产量大，约占塑料总产量的四分之三，价格低，大量用来制作受力不大的日用品，如电视机外壳、电话机外壳、塑料盆、塑料桶等。与人们的关系十分密切，成为塑料工业的重要支柱。常用的通用塑料有PE、PVC、PS、PP、PF、UF、MF等。

POM的长期耐热性能不高，但短期可达到160℃，其中均聚POM短期耐热比共聚POM高10℃以上，但长期耐热共聚POM反而比均聚POM高10℃左右。可在-40℃~100℃温度范围内长期使用。

LCP塑胶原料的特性；

- a、LCP具有自增强性：具有异常规整的纤维状结构特点，因而不增强的液晶塑料即可达到甚至超过普通工程塑料用百分之几十玻璃纤维增强后的机械强度及其模量的水平。如果用玻璃纤维、碳纤维等增强，更远远超过其他工程塑料。
- b、液晶聚合物还具有优良的热稳定性、耐热性及耐化学药品性，对大多数塑料存在的蠕变特点，液晶材料可以忽略不计，而且耐磨、减磨性均优异。
- c、LCP的耐气候性、耐辐射性良好，具有优异的阻燃性，能熄灭火焰而不再继续进行燃烧。其燃烧等级达到UL94V-0级水平。
- d、LCP具有优良的电绝缘性能。其介电强度比一般工程塑料高，耐电弧性良好。在连续使用温度200-300℃，其电性能不受影响。间断使用温度可达316℃左右。
- e、LCP具有突出的耐腐蚀性能，LCP制品在浓度为90%酸及浓度为50%碱存在下不会受到侵蚀，对于工业溶剂、燃料油、洗涤剂及热水，接触后不会被溶解，也不会引起应力开裂。

LCP塑胶原料的应用

- a、电子电气是LCP的主要市场：电子电气的表面装配焊接技术对材料的尺寸稳定性和耐热性有很高的要求（能经受表面装配技术中使用的气相焊接和红外焊接）。
- b、LCP：印刷电路板、人造卫星电子部件、喷气发动机零件、汽车机械零件、医疗方面。
- c、LCP加入高填充剂或合金（PSF/PBT/PA）作为集成电路封装材料、代替环氧树脂作线圈骨架的封装材料；作光纤电缆接头护套和高强度元件；代替陶瓷作化工用分离塔中的填充材料。代替玻璃纤维增强的聚矾等塑料（宇航器外部的面板、汽车外装的制动系统）。